УДК 538.911

СТРУКТУРА ГЕТЕРОГРАНИЦЫ Ga₂Se₃ — Si(100)

© 2011 Н. Н. Безрядин, Ю. В. Сыноров, Г. И. Котов, С. В. Кузубов

Воронежская государственная технологическая академия, пр-т Революции 19, 394036 Воронеж, Россия Поступила в редакцию 01.09.2011 г.

Аннотация. Методом просвечивающей электронной микроскопии исследована гетерограница Ga₂Se₃-Si(100), сформированная напылением в квазизамкнутом объеме из независимых источников галлия и селена. Предварительная обработка кремниевой подложки в потоке Ga с целью удаления естественного оксида позволяет получать монокристаллические эпитаксиальные пленки Ga₂Se₃. Установлены технологические параметры процесса, когда на микродифракционных изображениях появляются «видимые» плоскости Ga₂Se₃ (110) и (310), присутствие которых свидетельствуют о реконструкции поверхности Si(100) по типу (2×1) или с(4×2).

Ключевые слова: гетероструктура, селенид галлия, кремний, реконструкция поверхности, граница раздела.

введение

При формировании гетероструктур типа П'П (где П' — тонкая пленка полупроводника, отличающаяся по составу от материала подложки П) особое внимание уделяется однотипности кристаллической структуры и близости параметров решеток контактирующих материалов. Наряду с близостью термических коэффициентов расширения (ТКР) это условие должно определять как возможность получения эпитаксиальных монокристаллических пленок второй фазы (П'), так и более близкие к идеальным электрофизические характеристики гетероструктуры [1-2]. Понятен интерес исследователей к гетероструктурам на основе кремния, являющегося основным материалом современной микро- и наноэлектроники. Отвечает выше отмеченным требованиям система Ga₂Se₃—Si (для Si: TKP — 2,33.10⁻⁶ K⁻¹, параметр решетки — 0,543 нм; для Ga₂Se₃ — 9.10⁻⁶ K⁻¹ и 0,542 нм, соответственно; тип кристаллической решетки для обеих полупроводников — сфалерит). В работе [3] представлены результаты исследования гетероструктуры Ga₂Se₃ — Si (п- и р-типа), полученных по методике [4] в квазизамкнутом объеме (КЗО) с «горячими стенками» соиспарением из независимых источников. Получаемые этим способом пленки Ga₂Se₃ представляют собой крупноблочные поликристаллы с точной ориентацией блоков вдоль оси текстуры. Однако при повороте образца вокруг оси текстуры дифракционная картина не изменяется, что свидетельствует об отсутствии преимущественной азимутальной ориентации блоков. Причем ось текстуры пленок Ga₂Se₃ не зависит от ориентации Si подложки. Полагая, что ориентирующее действие подложки Si на растущий слой Ga₂Se₃ экранируется подслоем естественного оксида, в работе [5] для удаления собственного оксида предложено использовать обработку подложки в потоке атомов галлия. Используя подобную обработку в том же КЗО непосредственно перед осаждением Ga₂Se₃, в работе [6] методом электронографии «на отражение» установлено, что получаемые в таких условиях пленки имели структуру мозаичного монокристалла, дифракционная картина менялась при поворотах образца вокруг оси, перпендикулярной плоскости подложки. Это свидетельствует о строгой азимутальной ориентации кристаллических блоков, а присутствие на электронограмме дальних рефлексов — о малой угловой разориентации блоков, свойственной мозаичным монокристаллам [7]. Результаты детального исследования электрофизических характеристик гетероструктур Al — Ga_2Se_3 — Si (n- и р-типа), полученных таким способом, представлены в работе [8]. В результате исследования электрофизических характеристик некоторых свежеприготовленных образцов гетероструктур установлено, что плотность поверхностных электронных состояний (ПЭС) превышает значения, представленные в работе [8] на два порядка и составляет 10^{13} эВ·см⁻². Несмотря на то, что система Ga₂Se₃-Si(100) удовлетворяет формальным требованиям, предъяв-



Рис. 1. Электронограмма «на отражение» пленки Ga₂Se₃ на Si(100), полученной в K3O соиспарением Ga и Se после обработки поверхности Si в потоке атомов галлия, $T_{\rm n} \sim 1070$ K; $T_{\rm Ga} > 1370$ K

ляемым к качественному гетеропереходу, и следовало бы ожидать снижения плотности ПЭС. В связи с этим в настоящей работе методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) была исследована гетерограница Ga₂Se₃ — Si(100), сформированная после удаления подслоя естественного оксида.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения пленок Ga₂Se₃ использовался модифицированный реактор K3O, представляющий собой разъемную графитовую камеру с четырьмя независимыми регулируемыми зонами нагревания: подложки, стенок, источника галлия и источника селена [6]. Использованная методика формирования пленок аналогична предложенной в работе [3]. Кремниевые подложки готовились по стандартной технологии, используемой при производстве кремниевых СБИС. Предварительная обработка подложек в потоке атомов галлия проводилась при $T_{\rm n}$ =1070 К и $T_{\rm Ga}$ =1370 К непосредственно перед осаждением Ga₂Se₃ в том же КЗО. Источник селена в этом процессе закрыт и специально не нагревался. В режиме осаждения слоя температура источника селена T_{se}=490 К, источника галлия $T_{\rm Ga} = 1170$ К, а температура подложки варьировалась в диапазоне 960—1000 К. Состав слоев по данным PCMA отвечал стехиометрии Ga₂Se₃ при $T_{\rm Se}$ =470 К ($P_{\rm Se} \sim 10^{-1}$ Па). Снижение $T_{\rm Se}$ приводит к отклонению состава Ga₂Se₃ от стехиометрии в сторону обогащения конденсата галлием. Методом дифракции быстрых электронов «на отражение» исследована структура слоев Ga₂Se₃. Полученные электронограммы представлены на (рис. 1) и полностью соответствуют более ранним результатам исследований [3, 6].

С помощью ПЭМ Hitachi H-800 при ускоряющем напряжении 200 кВ были получены микродифракционные изображения гетерограницы Ga₂Se₃ — Si(100), сформированной в K3O соиспарением Ga и Se после удаления подслоя естественного оксида в потоке атомов галлия. Отверстия в образцах для этих исследований готовились по методике, описанной в [3, 6].

При температурах подложки ниже 970 К пленки имеют мелкодисперсную поликристаллическую структуру (рис. 2*a*). При повышении температуры подложки до 980 К формируются монокристаллические слои Ga₂Se₃ с ориентацией (100), соответствующей ориентации подложки Si(100) (рис. 2 δ).



Рис. 2. Микродифракционные изображения гетероструктуры $Ga_2Se_3 - Si(100)$: $T_n = 960$ K, $T_{Ga} = 1220$ K, $T_{Se} = 490$ K (*a*); $T_n = 980$ K, $T_{Ga} = 1140$ K, $T_{Se} = 490$ K (*b*)



Рис. 3. Микродифракционные изображения гетероструктуры Ga₂Se₃ — Si(100): $T_{\rm n}$ =1000К, $T_{\rm Ga}$ =1170 К, $T_{\rm Se}$ =490 К

После напыления на поверхность Si(100) пленки Ga₂Se₃ при *T*_п=1000 К, *T*_{Ga}=1170 К, *T*_{Se}=490 К на микродифракционных изображениях проявляются дополнительные системы рефлексов, отвечающие кристаллографическим плоскостям (110) и (310) (рис. 3). Поскольку данные рефлексы отсутствуют на микродифракционном изображении исходной поверхности Si(100) и из оценки относительных интенсивностей *I*/*I*₀ рефлексов от плоскостей {*hkl*} в последовательности, отвечающей направлению роста [100] следует, что «новые» экстрарефлексы не принадлежат обратной решетке подложки Si(100). Их появление можно связать с образованием границы раздела кремний — селенид галлия. Причем, селенид галлия является фазой α-Ga₂Se₃(100) с 33 % упорядоченных стехиометрических вакансий галлия, представляющей собой формальную реконструкцию (2×3) без дальнего порядка в соответствии с вакансионной моделью атомной структуры поверхности $Ga_2Se_3(100)$ предложенной в работе [9].

Известно, что в сверхвысоком вакууме поверхность Si(100) имеет реконструкцию (1×2), представленную на рис. 4 [11], где размер ячейки периодичности поверхности увеличивается в 2 раза вдоль направления [110] и остается неизменным вдоль направления [-110]. В связи с этим, в верхнем слое такой поверхности Si формируется ряд димеров вдоль направления [-110]. При этом установлено, что димеры наклонены на угол 14—18° [10, 11]. Взаимодействие между димерными рядами приводит к упорядочению наклонных димеров при температуре ~ 200 К и образованию антисимметричной структуры, в которой димеры в соседних рядах наклонены в противоположных направлениях. Эта структура имеет периодичность $c(4 \times 2)$ [11, 12]. Все виды реконструкции авторами этих работ наблюдались в сверхвысоком вакууме. В наших условиях вакуум в рабочем объеме составлял 5*10⁻⁴ Па. Но давление паров остаточных газов (в том числе и кислорода) внутри камеры КЗО в стационарном режиме испарения вещества на 3 порядка ниже давления газов во внешнем вакуумированном рабочем объеме, т.е. составляет около $5 \cdot 10^{-7}$ Па [13]. В связи с этим, в отсутствии кислорода, возможно, происходит реконструкция поверхности Si(100) по типу (1×2), которая формируется, как полагают авторы в работе [14], за счет димеризации соседних атомов Si с образованием σ- и π-связей. Такая реконструкция, вероятно, и является причиной возрастания плотности ПЭС на границе раздела. Здесь отметим, что реконструкция поверхности Si(100) даже в сверхвысоком вакууме приводит к увеличению плотности ПЭС в запрещенной зоне [12]. Ре-



Рис. 4. Модель атомной структуры поверхности Si(100) (1×2) [11]

конструированная в процессе обработки в потоке атомов Ga с последующим напылением селенида галлия поверхность Si(100) оказывает ориентирующее действие на последующий рост пленки Ga₂Se₃(100). В свою очередь, пленка Ga₂Se₃(100) стабилизирует реконструированную поверхность Si(100). При этом селенид галлия представляет собой фазу с упорядоченными стехиометрическими вакансиями галлия, что и объясняет появление на микродифракционных изображениях (рис. 3) «видимых» плоскостей (110) и (310), не отвечающих реальному направлению роста слоя Ga₂Se₃(100).

выводы

Таким образом, в результате исследования методом ПЭМ гетерограницы Ga₂Se₃ — Si(100), сформированной после обработки кремниевой подложки в потоке атомов галлия, установлено, что такая обработка позволяет получать эпитаксиальные слои Ga₂Se₃ (100) с упорядоченными стехиометрическими вакансиями галлия. В процессе напыления пленки селенида галлия в изучаемых условиях реконструированная по типу (1×2) поверхность кремния стабилизируется, что, видимо, и является причиной наблюдаемого резкого роста плотности ПЭС. Напротив, реконструкция поверхности GaAs(100) приводит к снижению плотности ПЭС. Последнее неоднократно наблюдалось в наших исследованиях гетерограницы Ga₂Se₃ GaAs(100), сформированной в процессе гетеровалентного замещения мышьяка на селен при термической обработке в КЗО подобном используемому в данной работе [15].

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

Безрядин Николай Николаевич — профессор, зав. кафедрой физики ВГТА; тел.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta.vrn.ru

Сыноров Юрий Владимирович — доцент, кафедра физики ВГТА; тел.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta. vrn.ru

Котов Геннадий Иванович — доцент, кафедра физики ВГТА; тел.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta.vrn. ru

Кузубов Сергей Вячеславович — доцент, кафедра физики ВГТА; тел.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta. vrn.ru

сии на 2007—2013 годы», государственный контракт № 16.516.11.6084 от 08.07.2011 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Милнс А., Фойхт Д.* Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник: Пер. с англ. М.: Мир, 1975. 432 с.

2. Алферов Ж. И. // ФТП. 1998. Т. 32. № 1. С. 3—18.

3. *Сысоев Б. И., Безрядин Н. Н., Сыноров Ю. В. и др.* // Неорган. Мат. 1991. Т. 27. № 3. С. 470—473.

4. *Бубнов Ю. 3., Лурье М. С., Старос Ф. Г. и др.* Вакуумное нанесение пленок в квазизамкнутом объеме. М.: Сов, радио, 1975. 160 с.

Wright S., Kroemer H. // Appl. Phys. Lett. 1980. V.
36. № 3. P. — 210—211.

6. Безрядин Н. Н. Сыноров Ю. В., Самойлов А. М. и др. // Вестник ВГТУ. Сер. Материаловедение. 2002. Вып. 1.11. С. 47—51.

7. Иевлев В. М., Кущев С. Б. Просвечивающая электронная микроскопия неорганических материалов: учебное пособие. Воронеж: ВГТУ, 2003. 164 с.

8. Безрядин Н. Н., Дронов А. С., Кузьменко Т. А. и др. // Микроэлектроника. 1998. Т. 27. № 5. С. 353—356.

9. *Безрядин Н. Н., Котов Г. И., Кузубов С. В. И др.* // Кристаллография. 2011. Т. 56. № 3. С. 565—569.

10. Ong C. K., Chan B. C. // J. Phys.: Condens. Matter. 1989. V. 1. P. 3931.

11. Оура К. Лифшиц В. Г., Саранин А. А. и др. Введение в физику поверхности. М.: Наука, 2006. 490 с.

12. Бехитедт Ф., Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупроводников: Пер. с англ. М.: Мир, 1990. 448 с.

13. Кондратов А. В., Потапенко А. А. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий радиоэлектроники. М.: Радио и связь, 1986. 80 с.

14. Bokes P., Stich I., Mitas L. // Chemical Physics Letters. 2002. V. 362. P. 559—566.

15. *Безрядин Н. Н., Котов Г. И., Кузубов С. В. и др.* // Конденсированные среды и межфазные границы. 2010. Т. 12. № 1. С. 28—35.

Bezryadin Nikolay N — grand PhD, professor, department of physics VSTA; tel.: (473) 255-0762, e-mail: phys@ vgta.vrn.ru

Synorov Yurii V. — senior lecturer, department of physics VSTA; tel.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta.vrn.ru

Kotov Gennadii I. — senior lecturer, department of physics VSTA; tel.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta. vrn.ru

Kuzubov Sergey V. — senior lecturer, department of physics VSTA; tel.: (473) 255-0762, e-mail: phys@vgta. vrn.ru